

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向平安银行上海分行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、授信情况概述

公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币15,000.00万元（含人民币15,000.00万元），该授信额度为纯信用无担保方式。用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。本议案无需提交股东大会审议通过。董事会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、本次交易目的和对公司的影响

公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度是基于公司实际业务发展需要，有利于缓解公司的资金压力，有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律、法规的情形。

三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年11月22日